



Do klejenia izolacji termicznej używać fabrycznie przygotowanych mas klejowych do zmieszania z wodą na budowie. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

① Zaprawa klejowa

② Płyta styropianowa gr. 14cm

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	Remont budynku wielorodzinnego ul. Boczna 1; 58-540 Karpacz	Konstrukcja Mgr inż. Robert Wieczorkowski	UPRAWNIENIA 294/00/DUW
INWESTOR	Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	OPRACOWAŁ Inż. Tomasz Korzeniowski	PODPIS
		RYSUNEK Nakładanie masy klejowej na płytę Szczegół techniczny	SKALA
			DATA Czerwiec 2010
			NR RYS. 6